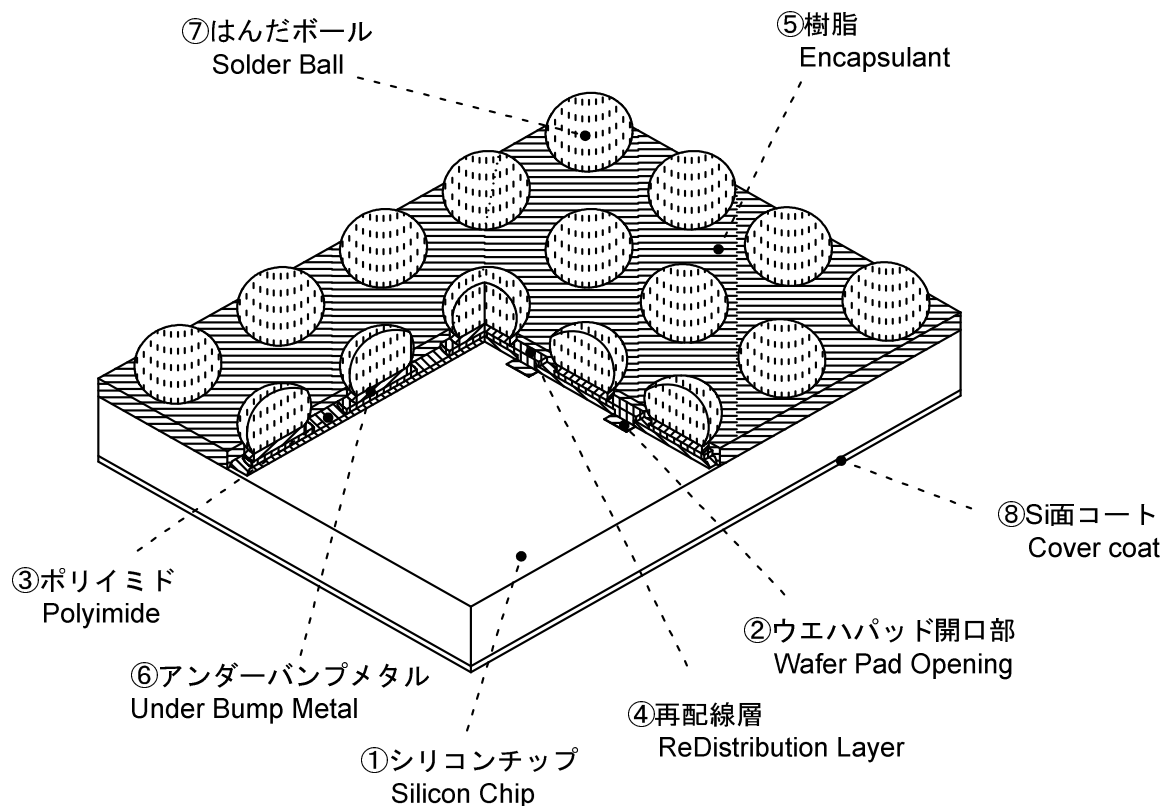


WLP-20-01構造図
WLP-20-01 Perspective

RoHS対応品
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
① シリコンチップ Silicon Chip	シリコン Silicon	
② ポリイミド Polyimide	ポリイミド Polyimide	
③ 再配線層 ReDistribution Layer	銅 + チタン Copper + Titanium	
④ 樹脂 Resin	エポキシ Epoxy	
⑤ アンダーバンプメタル Under Bump Metal	銅 Copper	
⑥ はんだボール Solder Ball	スズ + 銀 + 銅 Tin + Silver + Copper	
⑦ Si 面コート Cover coat	エポキシ Epoxy	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------